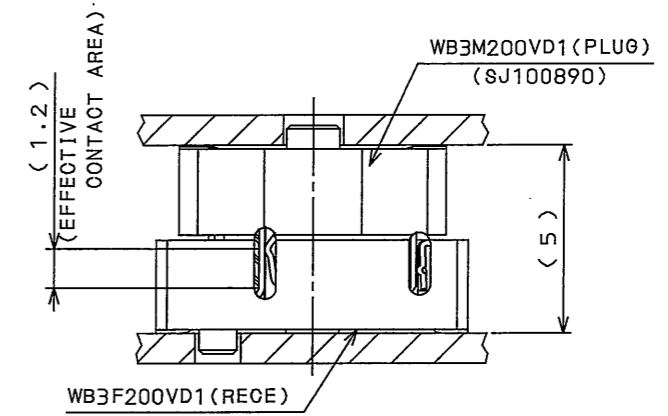
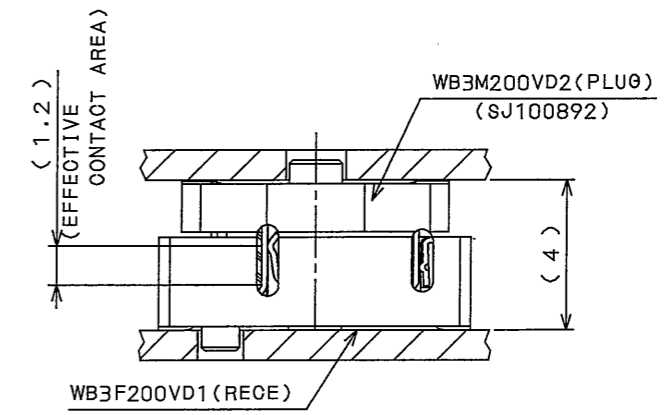
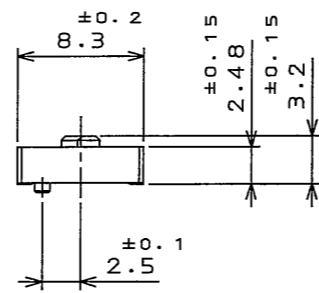
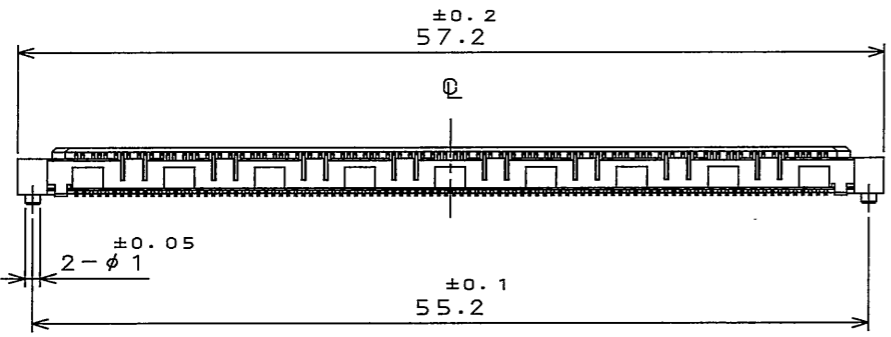
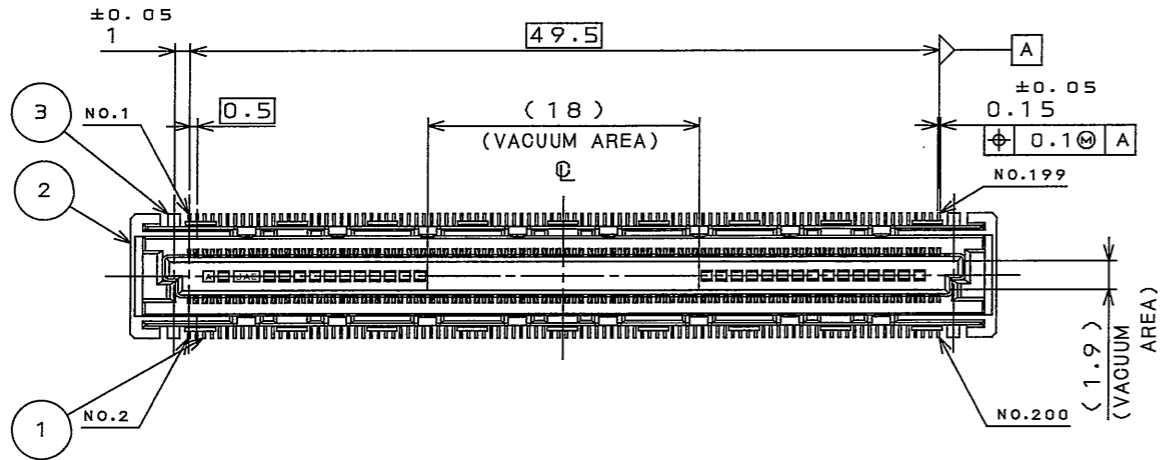


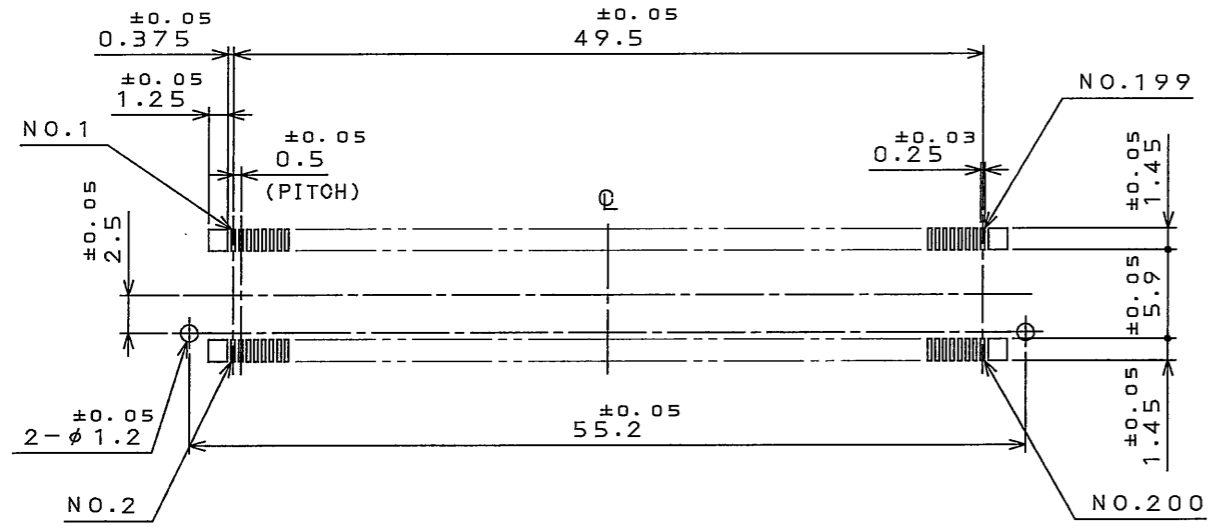
版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.

88801SJ
(ON 0NIMVHD) (DRAWING NO.)



MATED CONDITION (REF.)
嵌合状態図(参考)

NOTE1. COPLANALITY OF SMT TERMINAL IS 0.1 MAX.
注1. コンタクトのコプラナリティは0.1以下とする。



APPLICABLE P.C.B. DIMENSION (REF.)
適合基板寸法(参考)

3	SHELL	2	COPPER ALLOY	REFLOW TIN PLATING	
2	INSULATOR	1	HEAT RESISTING PLASTICS		COLOR: BLACK UL94 V-0
1	CONTACT	200	COPPER ALLOY	CONTACT AREA: GOLD (0.76μm MIN) TERMINAL AREA: GOLD FLASH	
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION) JACS-10174		第1版 (ORIGINAL DATE) 19.Apr.2004		尺度 (SCALE) 5:1 列名 (REF.) WB3	
公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称 (TITLE) Reference Only	
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK. H.OBIKANE		WB3F200VD1	
角度 (ANGLES)		査閲 APPD. Y.YAHIRO		RECEPTACLE	
. ±		承認 APPD. S. Kashiwagi		重量 (WEIGHT)	
.X ±				図面番号 (DRAWING NO.) SJ100888	
.XX ±				版数 (REV.) 1	
.XXX ±					

DOF-0-212E(03.08)

